

ひとわざ(一技)名: 半導体ベアチップ実装と高精度フィルム貼合技術

1. 概要

試作1個から量産・評価検査までワンストップサービスで承ります。
市場トレンドを捉えた確かな技術で、お客様のニーズに迅速に応えます。

◆半導体デバイスのベアチップ実装

ワイヤーボンディング、フリップチップボンディング、SMTなど、多様な工法に柔軟に対応。シーム溶接による気密封止にも対応。

◆ディスプレイ・貼合

ディスプレイのモジュール組立をはじめ、平板や曲面形状の部品・ガラス等への機能性(加飾)フィルムの貼り合わせ、剛体同志の貼り合わせにも柔軟に対応。

◆組立:光学機器・精密機器・電子機器組立

写真・図(要点説明)

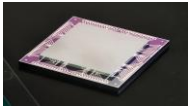
●ワイヤーボンディング



・金線・銀線・銅線・アルミ線に対応しています。

・アルミ線は、太線 (Φ100～500μm) ・細線 (φ20～50μm)

●フリップチップ実装



・マイクロバンプ接合(チップレット)。最先端実装機を保有しております。

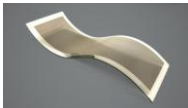
・高精度チップ搭載(搭載精度±1μm)

●ダイレクトボンディング



・OCAやOCRを用いてカバーガラスやタッチパネルをディスプレイへ接着するダイレクトボンディングが可能です。

●曲面貼合 (2.5D、3D) ※2D(平面to平面もご対応しております)



・曲面へのフィルム貼合は、形状や材質、サイズによって最適な方法が異なります。

2. 企業概況

フリガナ	カブシキカイシャ イングスシナノ			フリガナ	コバヤシ ヒデトシ		
会社名	株式会社イングスシナノ			代表者名	小林 秀年		
				フリガナ	エイギョウブ		
				窓口担当	営業部		
事業内容	実装、ディスプレイ・貼合、組立			URL	https://www.ings-s.co.jp/		
主要製品	半導体デバイスのベアチップ実装、ディスプレイ・貼合、組立：光学機器・精密機器・電子機器組立						
フリガナ	ナガノケン スワグン シモスワマチ キタシオウ						
住所	〒393-0042 長野県諏訪郡下諏訪町北四王5415						
電話/FAX	02666-27-8056 / 0266-28-0325			E-mail	ings-sales@ings-s.co.jp		
資本金(百万円)	20	設立年月	1946年	売上(百万円)	—	従業員数	70

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③SDGsへの取り組み 他)

- ①ISO9001、ISO14001、IATF16949、(ISO13485認証取得準備中)、光学機器製造技能士
②半導体ベアチップ実装と平面・曲面への高精度フィルム貼合を強みに、試作1個から量産・検査までワンストップで受託し、車載・精密電子機器等の幅広い分野へ最適な技術を提供します。
③長野県SDGs推進企業。ISO14001に則り生産設備の省エネ(GX)を推進。自社で産業廃棄物処分業(中間処理)の許可も保有し、廃プラスチック類の資源循環リサイクルを通じて持続可能な社会に貢献しています。